

ELEKTRONIKAI GYÁRTÁS ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS – VIETAC05

Félévi követelmények

- 3 félévközi kis ZH: 03.01, 03.29, 05.03

kiskérdések: 4 pontos ZH-k, összesen 12 pont (2 számítási példa),

aláírás megszerzése: legalább 2 ZH-n min. 2-2 pont.

- Tantermi gyakorlatok:

Tgy1: 02.15, Tgy2: 03.01, Tgy3: 03.29, Tgy4: 04.19,

Tgy5: 05.03, Tgy6: 05.17

aláírás megszerzése: részvétel min. 4 alkalmon

- Vizsga:

teljes tétel (~1 előadás ppt), 15 perc írásbeli felkészülés + szóbeli vizsga

Ajánlott irodalom

- http://www.amcham.hu/download/006/770/Elektronikai_gyartas_20101126.pdf
- Ning-Cheng Lee: „Reflow Soldering Processes and Troubleshooting: SMT, BGA, CSP and Flip Chip Technologies”, Newnes, USA 2002
- Clyde F. Coombs: „Printed Circuits Handbook”, 6. kiadás, McGraw-Hill, USA, 2008
- George Harman: „Wire bonding in Microelectronics”, 3. kiadás, McGraw-Hill, USA, 2010